



# Mate2017 第23回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

— IoT時代に求められる電子システム創成 — **参加者募集**

**日 時**：平成29年1月31日（火）8：50～17：40  
 2月1日（水）8：50～17：05  
**会 場**：パシフィコ横浜 会議センター  
 横浜市西区みなとみらい1丁目1-1  
**主 催**：（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会  
 （一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
**共 催**：（一社）エレクトロニクス実装学会  
 （公社）化学工学会 エレクトロニクス部会  
 （一社）レーザ加工学会  
**協 賛**：応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

## 〈開催趣旨〉

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

## 【シンポジウム参加登録費（論文集代を含む）】

- 主催団体個人会員：20,000円
- 大学・国公立研究機関：20,000円
- 口頭発表者・座長：20,000円
- 主催団体維持・賛助会員：25,000円
- 共催団体会員：25,000円
- 協賛団体会員：30,000円
- 一般：35,000円
- 学生：10,000円

## 【シンポジウム参加申込方法】

下記シンポジウムURLより、平成29年1月13日（金）までに参加登録を行って下さい。

<http://sps-mste.jp/mate2017/src/index.html>（11月中受付開始）

○参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、当日現金にてお支払い願います。

振込先銀行：三井住友銀行 千里中央支店

口座番号：普通0978673

口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ]

振込期日：平成29年2月28日（火）

○シンポジウム1日目に懇親会を開催します。シンポジウム参加申込時にお申し込みください。

懇親会参加費：5,000円

## 【問合せ、申込先】Mate 2017 事務局

（ものづくりリエゾンオフィス（MLO）内）

TEL：06-6878-5628 FAX：06-6879-7568

E-mail：mate@sps-mste.jp

シンポジウムURL：

<http://sps-mste.jp/mate2017/src/index.html>

## プログラム（セッション名と発表件数）

●プレナリーセッション（1月31日（火）13：50～15：50）

「IoT時代に求められる電子システム創成」

1. オープンIoTで創る新しい社会：  
坂村 健氏 東京大学
2. IoTを巡る動向とものづくりの将来展望：  
澤田 浩之氏 産業技術総合研究所
3. 「シミュレーション統合生産」によるサイバーフィジカル動的最適化生産～IoT時代に先見力を与える予測的エンジニアリング～：  
中村 昌弘氏 ㈱レクサーリサーチ
4. 製造現場におけるIoTを活用した生産革新：  
松原 伸治氏 三菱電機㈱

| 1月31日（火）8：50～17：40                                                                                                                                                                                                                    | 2月1日（水）8：50～17：05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A-1] パワーデバイス（1）（5件）<br>[A-2] ナノ・マイクロマテリアル（5件）<br>[B-1] 実装材料の信頼性評価（5件）<br>[B-2] 回路基板・パッケージ（講演1件＋論文3件）<br>[C-1] マイクロ加工（5件）<br>[C-2] 生産・製品システム（講演1件＋論文4件）<br><br>プレナリーセッション 13：50～<br>ポスタープレゼン 16：00～<br>ポスターセッション 16：40～<br>懇親会 17：50～ | [A-3] ソルダリング（1）（4件）<br>[A-4] ソルダリング（2）（4件）<br>[A-5] パワーデバイス（2）（4件）<br>[A-6] パワーデバイス（3）（4件）<br>[A-7] パワーデバイス（4）（4件）<br>[B-3] 実装構造における疲労信頼性評価（4件）<br>[B-4] 接着技術（4件）<br>[B-5] 樹脂実装（4件）<br>[B-6] 3D実装（4件）<br>[B-7] MEMS・医療センサ（4件）<br>[C-3] プリントブルエレクトロニクス（4件）<br>[C-4] 熱マネジメント（4件）<br>[C-5] マイクロ接合（1）（4件）<br>[C-6] マイクロ接合（2）（4件）<br>[C-7] 新材料・プロセス（4件）<br>（依頼講演2件＋一般論文発表87件 合計89件） |